

文稿頁面

文號：1130001097

檔 號：113/1999/1/
保存年限：3年

便簽 日期：113年1月16日
單位：工學院
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

- 一、擬公告訊息於系網頁，敬請踴躍報名。
- 二、陳閱後文存。

會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
行政 辦事員 劉元卉 0116 0836		教授兼 工學院院長 楊明德 0116 1339
教授兼土木工程 學系系主任 陳榮松 0116 1308		代為決行
秘書 羅濟統 0116 1339		

國立中興大學



檔 號：

保存年限：

台灣發明商品促進協會 函

機關地址：105台北市松山區八德路二段
400號7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898#19

Email：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國113年1月15日

發文字號：台發協字第1130011502號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件一 1130011502_Attach1.pdf、附件二 1130011502_Attach2.docx)

主旨：本協會辦理「2024馬來西亞PiENVEX國際工程創新發明展」，敬請惠予公告並轉知 貴校師生踴躍參加。

說明：

- 一、「2024馬來西亞PiENVEX國際工程創新發明展」是一個全球公認的展覽，旨在展示新的研究和創新的解決方案。透過展覽中的研討會、創新發表會以及廠商媒合會，為您提供更多商業機會，同時推動科學和技術的進步。
- 二、參展日期：113年4月26日至4月28日。
- 三、參展地點：Dewan Ilmu會展中心，馬來西亞玻璃市
- 四、聯絡方式：wiipa168@wiipa.org.tw或02-8772-3898賴小姐

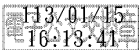
正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大

國立中興大學

第1頁，共7頁
線上簽核文件列印 - 第2頁/共8頁

1130001097 113/01/15

學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：

裝

施養隆 會長

訂



2024 馬來西亞國際工程創新發明展 PiENVEX

我們很榮幸地邀請您參加「2024 馬來西亞 PiENVEX 國際工程創新發明展」，這是一個全球公認的展覽，旨在展示新的研究和創新的解決方案。此次活動將於 4 月 26 日至 28 日在馬來西亞的玻璃市隆重舉行。

PiENVEX 的目標是促進國際間的交流和合作，將世界各地的創意和創新匯聚在一起，推動科學和技術的發展。這不僅是一個展示您最新研究成果和解決方案的機會，還是一個學習和交流的平台，有助於激發您的創造力和潛力。

透過 PiENVEX 展覽中的研討會、創新發表會以及廠商媒合會，為您提供更多商業機會，同時推動科學和技術的進步。這也是一個促進跨學科合作的良機，有助於為未來的科學和技術發展建立重要的平台。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會，誠摯地邀請您參與 PiENVEX，與世界各地的同行共同分享您的研究、交流您的想法，並在這個國際盛會上展現您的創新成果。



世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗
台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀

2024 馬來西亞國際工程創新發明展

PiENVEX

主辦單位：馬來西亞研究與創新協會

展覽日期：2024年4月26日~4月28日

展覽地點：Dewan Ilmu會議展覽中心，馬來西亞玻璃市

參展費用：35,000/件，包含5位發明人報名費、展位費、桌椅及評比費。

選購品項：3,000/件，海報設計及印刷。

託展費用：10,000/件，包含現場布置、解說及作品運送。

早鳥加碼：2024年3月31日前報名，贈送一則電子新聞曝光。(由TIPPA
挑選最佳曝光之電子媒體，視參賽作品之屬性而定。)

【WIIPA及TIPPA 配合之電子媒體】

Google新聞、台灣產經新聞網、台灣新聞聯播網、
Yam蕃新聞、NEWSBUFFET、數位之牆、match生活網



報名資訊：台灣發明商品促進協會 (TIPPA)

報名日期：2024年3月31日截止

繳費日期：2024年4月7日截止，逾期取消參賽資格

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215

[在此鍵入]



World Invention
Intellectual Property
Associations



2024 馬來西亞國際工程創新發明展
報名表



連絡單位	中文名稱： 聯 絡 人： 職 稱： 連絡電話： 電子信箱：
參賽作品	中文名稱： 英文名稱：
參 賽 人 (至多 5 位)	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(未填者視同放棄縣市政府接見的機會)
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：



[在此鍵入]



World Invention
Intellectual Property
Associations



2024 馬來西亞國際工程創新發明展
報名表

專利申請	☐ 已核准號碼_____
	☐ 申請中案號_____
	☐ 尚未申請
作品屬性	☐ 商品化
	☐ 原型
	☐ 模型
	☐ 圖稿
作品簡介	中文摘要：(不限字數)
	英文摘要：(限定 200 字元，大會手冊印刷系統將自動刪除超過的字元。)
作品相片	



[在此鍵入]



World Invention
Intellectual Property
Associations



2024 馬來西亞國際工程創新發明展

報名表



作品類別 (限勾選一項)	☐ 農業、生物技術和食品工業 ☐ 人工智能 ☐ 建築與材料 ☐ 能源、電力 ☐ 環境和污染控制 ☐ 工業和製造業 ☐ 信息技術、多媒體和通信 ☐ 創新研究 ☐ 機械工程與冶金學 ☐ 醫學、生物醫學、醫療保健和化妝品 ☐ 人身安全、保護和救援 ☐ 體育、遊戲和休閒 ☐ 無人機系統、運輸和汽車產業
參展目的	☐ 廣告曝光 ☐ 現場販售 ☐ 技術移轉 ☐ 代理合作 ☐ 批發合作 ☐ 製造合作 ☐ 個人履歷
注意事項	1. Word 檔報名表請勿轉為 PDF 檔 2. 海報尺寸：90cm x 150cm 3. 檔案傳送：wiipa168@wiipa.org.tw 4. 連絡電話：02-8772-3898 5. 報名日期：2024 年 3 月 31 截止 6. 繳費日期：2024 年 4 月 7 日截止，逾期取消參賽資格
匯款資訊	台灣發明商品促進協會 元大銀行營業部 00108253826215